# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-283049

(43) Date of publication of application: 03.10.2003

(51)Int.Cl.

H01S 5/125

(21)Application number: 2002-079355

(71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22) Date of filing:

20.03.2002

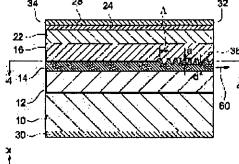
(72)Inventor: MIKI ATSUSHI

## (54) SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor laser element suitable for the forward direction excitation light source of a Raman amplifier.

SOLUTION: The semiconductor laser element 100 is provided with an active layer 45 of a multiplex quantum well structure, separation closing heterodyne structure (SCH) layers 42, 44, 50, 52 which are provided above and below the active layer 45. A clad layer 16 is provided on the upper surface of the SCH layer 52. A diffraction grid 35 is provided in the interface between the SCH layer 52 and the clad layer 16 along only one part of length of the active layer. The diffraction grid 36 is provided at only the vicinity of front end surface of the laser element 100. The diffraction grid 36 is provided with a period, continuously changed along the lengthwise direction of the same. According to this constitution, multimode x oscillation can be achieved. When the range of the periodic change is set properly, a sufficiently narrow luminous spectrum width is obtained.



#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-283049 (P2003-283049A)

(43)公開日 平成15年10月3日(2003.10.3)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01S 5/125

H01S 5/125

5 F O 7 3

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願2002-79355(P2002-79355)

(22)出顧日

平成14年3月20日(2002.3.20)

(71)出願人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 三木 淳

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電

気工業株式会社横浜製作所内

(74)代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (外4名)

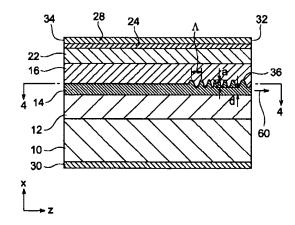
Fターム(参考) 5F073 AA65 AA74 AA83 CA12 EA01

## (54) 【発明の名称】 半導体レーザ素子

### (57)【要約】

【課題】 ラマンアンプの順方向励起光源に適した半導体レーザ素子を提供する。

【解決手段】 本発明の半導体レーザ素子100は、多重量子井戸構造の活性層45と、その上下に設けられた分離閉じ込めへテロ構造(SCH)層42、44、50、52を備えている。最も上に位置するSCH層52の上面にはクラッド層16が設けられている。SCH層52とクラッド層16との界面には、活性層の長さの一部分のみに沿って、回折格子36が設けられている。回折格子36は、レーザ素子100の前端面の付近にのみ設けられる。回折格子36は、長手方向に沿って連続的に変化する周期を有している。これによりマルチモード発振が達成される。周期変化の範囲を適切に設定すれば、十分に狭い発光スペクトラム幅が得られる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の導電型の半導体からなる基板と、 前記基板の上面側に設けられ、第1導電型の半導体から なる下部クラッド層と、

前記下部クラッド層の上に設けられた下部分離閉じ込め ヘテロ構造層と、

前記下部分離閉じ込めヘテロ構造層の上に設けられ、多 重量子井戸構造を有する活性層と、

前記活性層の上に設けられた上部分離閉じ込めヘテロ構

前記上部分離閉じ込めヘテロ構造層の上面に被着され、 前記第1導電型と異なる第2の導電型の半導体からなる 上部クラッド層と、

前記上部クラッド層の上に設けられた上部電極と、 前記基板の下面側に設けられた下部電極と、

無反射コートが施された前端面と、

前記前端面に対向し、髙反射コートが施された後端面 と、を備え、

前記上部分離閉じ込めヘテロ構造層と前記上部クラッド 層との界面には、前記活性層の長さの一部分のみに沿っ 20 て回折格子が設けられており、

前記回折格子は、前記前端面の付近にのみ設けられてお り、

前記回折格子は、その長手方向に沿って連続的に変化す る周期を有しており、

発振縦モードが2本以上の発光スペクトラムを有する半 導体レーザ素子。

【請求項2】 前記回折格子は、前記発振縦モードの波 長の光に対して、前記前端面の反射率よりも高い反射率 を有している請求項1記載の半導体レーザ素子。

【請求項3】 前記基板、下部クラッド層および上部ク ラッド層はIn Pから構成され、

前記下部分離閉じ込めヘテロ構造層、活性層、および上 部分離閉じ込めヘテロ構造層はInGaAsPから構成 されている請求項1記載の半導体レーザ素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体レーザ素子 に関し、特に、ラマンアンプの励起光源に適した半導体 レーザ素子に関する。

[0002]

【従来の技術】ラマンアンプの励起光源としては、外部 グレーティング共振器型の半導体レーザが知られてい る。これは、ファブリペロー (FP)型レーザの一方の ファセットを無反射コーティングし、他方のファセット とFP型レーザの外部に配置されたグレーティング(回 折格子)とで外部共振器を構成するレーザである。最近 では、外部グレーティングとして、ファイバブラッググ レーティング (FBG) がしばしば使用されている。と のような外部FBG共振器型レーザには、波長選択性が 50 【発明の実施の形態】本発明の実施形態を説明する前

よいという利点がある。また、外部FBG共振器型レー ザには、FP型レーザに比べて発振波長の電流依存性・ 温度依存性が小さいという利点もある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ラマンアンプの髙性能 化のためには、信号光に対して順方向と逆方向の双方か ら励起光を加える双方向励起方式が望ましい。順方向励 起では、励起光源の雑音特性が信号光に強く影響する。 したがって、相対雑音強度(RIN)の極めて低い励起 10 光源が必要となる。外部FBG共振器型レーザは、優れ た波長安定性を有するが、ラマンアンプの順方向励起に 十分なほどRINを低くすることは難しい。実際、その ような低RINの外部FBG共振器型レーザは、いまだ 実現されていない。

【0004】そこで、本発明は、ラマンアンプの順方向 励起に適した半導体レーザ素子の提供を課題とする。 [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザ素 子は、(a)第1の導電型の半導体からなる基板と、

(b) 基板の上面側に設けられ、第1導電型の半導体か らなる下部クラッド層と、(c)下部クラッド層の上に 設けられた下部分離閉じ込めヘテロ構造層と、(d)下 部分離閉じ込めヘテロ構造層の上に設けられ、多重量子 井戸構造を有する活性層と、(e)活性層の上に設けら れた上部分離閉じ込めヘテロ構造層と、(f)上部分離 閉じ込めヘテロ構造層の上面に被着され、第1導電型と 異なる第2の導電型の半導体からなる上部クラッド層 と、(g)上部クラッド層の上に設けられた上部電極

と、(h)基板の下面側に設けられた下部電極と、

(i)無反射コートが施された前端面と、(j)前端面 に対向し、高反射コートが施された後端面とを備えてい る。上部分離閉じ込めヘテロ構造層と上部クラッド層と の界面には、活性層の長さの一部分のみに沿って回折格 子が設けられている。との回折格子は、前端面の付近に のみ設けられている。この回折格子は、その長手方向に 沿って連続的に変化する周期を有している。本発明の半 導体レーザ素子は、発振縦モードが2本以上の発光スペ クトラムを有している。

【0006】回折格子の周期の各値は、長手方向の少な くとも二つの位置で現れてもよい。つまり、同じ周期が 繰り返し現れてもよい。回折格子は、発振縦モードの波 長の光に対して、前端面の反射率よりも高い反射率を有 していてもよい。基板、下部クラッド層および上部クラ ッド層がInPから構成され、下部分離閉じ込めヘテロ 構造層、活性層、および上部分離閉じ込めへテロ構造層 がInGaAsPから構成されていてもよい。下部分離 閉じ込めヘテロ構造層、活性層、および上部分離閉じ込 めヘテロ構造層はメサ構造を有していてもよい。

[0007]

に、本発明の概要を説明する。

【0008】分布帰還型(DFB)半導体レーザは、波 長安定性が高く、RINが低いという特性を有してい る。との点は、ラマンアンプの順方向励起光源に適して いる。しかし、既存のDFBレーザをラマンアンプの励 起光源として実際に使用すると、十分な励起光パワーを 維持できない。これは、DFBレーザ光が光ファイバの 内部でブルリアン散乱を起とすからである。

【0009】DFBレーザ光のブルリアン散乱が顕著な ド発振) するからである。そとで、本発明者は、DFB レーザと同じように回折格子を有し、それでいてマルチ モード発振(縦多モード発振)をする半導体レーザ素子 を考案した。とれが、本発明の半導体レーザ素子であ

【0010】本発明者は、既存のDFBレーザと同様の 構造を有する半導体レーザ素子であっても、長手方向に 沿って周期が連続的に変化する回折格子を有するものは マルチモード発振しうることを見出した。さらに、本発 近にのみ設けると好適であることを見出した。回折格子 の周期変化の範囲を適切に設定すれば、マルチモードで はあるがスペクトラム幅の十分に狭いレーザ光が生成さ れる。また、DFBレーザと同様に、波長安定性が高 く、RINが低い。マルチモード発振するから、光ファ イバ内のブルリアン散乱も抑えられる。したがって、本 発明の半導体レーザ素子は、ラマンアンプの励起光源と して好適である。

【0011】以下、添付図面を参照しながら本発明の実 一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略す る。また、図示の便宜上、図面の寸法比率は説明のもの と必ずしも一致しない。

【0012】図1は、本実施形態の半導体レーザ素子1 00の構造を示す斜視図である。半導体レーザ素子10 0は、基板10の上面に順次に被着された下部クラッド 層12、多重量子井戸-分離閉じ込め構造(MQW-S CH) 層14、および第1上部クラッド層16を備えて いる。これらは、いずれもメサ型の半導体層である。基 板10および下部クラッド層12は、いずれもn-In 40 長を有している。 Pから構成されている。MQW-SCH層14は、4元 化合物半導体のInGaAsPから構成されている。第 1上部クラッド層16は、p-InPから構成されてい

【0013】下部クラッド層12、MQW-SCH層1 4、および第1上部クラッド層16の両側面は、埋め込 み層18によって覆われている。埋め込み層18はp-1nPから構成されている。埋め込み層18の上には、 電流ブロック層20が設けられている。電流ブロック層 20は、n-InPから構成されている。第1上部クラ 50 mのバンドギャップ波長を有し、各井戸層48は、1.

ッド層16、埋め込み層18、および電流ブロック層2 0の上には、第2上部クラッド層22が被着されてい る。第2上部クラッド層22は、p-InPから構成さ れている。このように、n型の電流ブロック層20が、 p型の第2上部クラッド層22とp型の埋め込み層18 との間に介在している。

【0014】第2上部クラッド層22の上面には、コン タクト層24が被着されている。コンタクト層24は、 p'-InGaAsから構成されている。コンタクト層 のは、DFBレーザがシングルモード発振(縦単一モー 10 24の上面には、上部電極層28が被着されている。基 板10の下面には、下部電極層30が被着されている。 コンタクト層24に隣接する第2上部クラッド層22 は、第1上部クラッド層16よりも高いp型導電性を有 していてもよい。下部電極層30に隣接する基板10 は、下部クラッド層12よりも高いn型導電性を有して いてもよい。

【0015】第1上部クラッド層16、第2上部クラッ ド層22および下部クラッド層12は、MQW-SCH 層14で発生した光をMQW-SCH層14内に閉じ込 明者は、その回折格子を無反射コートされた前端面の付 20 めるためのものである。したがって、これらのクラッド 層は、MQW-SCH層14よりも低い屈折率を有して いる。

> 【0016】以下では、図2を参照しながら、MQW-SCH層14の構造を詳細に説明する。図2は、MQW -SCH層14のバンドギャップ波長の分布を示す図で ある。図2において、縦軸(x)は半導体レーザ素子1 00の垂直方向(厚さ方向)距離を示し、横軸(λ。) はバンドギャップ波長を示している。

【0017】図2に示されるように、MQW-SCH層 施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同 30 14は、下部クラッド層12から第1上部クラッド層1 6へ向かって、第1SCH層42、第2SCH層44、 活性層45、第3SCH層50および第4SCH層52 が順次に積層された多層半導体である。各層は、4元化 合物半導体のInGaAsPで構成されている。

> 【0018】第1SCH層42と第4SCH層52は、 対になって分離閉じ込めヘテロ構造を形成している。第 1SCH層42と第4SCH層52は、同じパンドギャ ップを有する。具体的には、第1SCH層42と第4S CH層52は、ともに1.05μmのバンドギャップ波

> 【0019】第2SCH層44と第3SCH層50も、 対になって分離閉じ込めヘテロ構造を形成している。第 2SCH層44と第3SCH層50は、同じパンドギャ ップを有する。具体的には、第2SCH層44と第3S CH層50は、ともに1.1μmのバンドギャップ波長 を有している。

> 【0020】活性層45は、複数のバリア層46および 複数の井戸層48が交互に積層された多重量子井戸(M QW) 構造を有している。各バリア層46は、1.2 μ

48 μmのバンドギャップ波長を有している。

【0021】MQW-SCH層14は、バンドギャップ 波長分布と同様の屈折率分布を有している。すなわち、 井戸層48、バリア層46、SCH層44および50、 SCH層42および52の順に高い屈折率を有してい る。第2SCH層44と第3SCH層50は同じ屈折率 を有する。また、第1SCH層42と第4SCH層52 は同じ屈折率を有する。このような屈折率分布により、 活性層45で生じた光は、MQW-SCH層14内に良 好に閉じ込められる。

【0022】具体的に述べると、各井戸層48は、3. 506の屈折率を有している。各バリア層46は、3. 312の屈折率を有している。第250日層44および 第3SCH層50は、それぞれ3.244の屈折率を有 している。第1SCH層42および第4SCH層52 は、それぞれ3.206の屈折率を有している。下部ク ラッド層12および第1上部クラッド層16は、それぞ れ3.100の屈折率を有している。

【0023】とのようなバンドギャップ波長分布と屈折 率分布は、InGaAsPの組成を調整することにより 20 実現できる。

【0024】以下では、図3および図4を参照しなが ら、半導体レーザ素子100の構造について更に説明す る。図3は、図1の3-3線に沿った、半導体レーザ素 子100の縦断面図である。図4は、図3の4-4線に 沿った、半導体レーザ素子100の平面断面図である。 【0025】半導体レーザ素子100の前端面32に は、活性層45で発生した光に対する反射率が結晶へき 開面より小さくなるように、AR (Anti-Reflection: 無反射) コートが施されている。本実施形態では、前端 30 モードの波長に対して、前端面32よりも高い反射率を 面32の反射率(AR反射率)は0.5%である。半導 体レーザ素子100の後端面34には、活性層で発生し た光に対する反射率が結晶へき開面より大きくなるよう に、HR (High Reflection: 高反射) コートが施され ている。本実施形態では、後端面34の反射率(HR反 射率)は90%である。半導体レーザ素子100で生成 されたレーザ光は、矢印60で示されるように、前端面 32から出射する。

【0026】MQW-SCH層14と第1上部クラッド 層16との界面(より具体的には、第4SCH層52と 40 第1上部クラッド層16との界面)には、回折格子36 が設けられている。回折格子36は、第450円層52 の上面に設けられた正弦波形状の構造である。図4に示 されるように、回折格子36の形状は、水平方向(図1 の y 方向) に沿って一様である。

【0027】回折格子36は、活性層45の長さの一部 分のみに沿って形成されている。回折格子36は、前端 面32の付近にのみ設けられている。したがって、回折 格子36は、後端面34から離間している。回折格子3

は300 µ m であり、活性層45の全長は900 µ m で ある。つまり、回折格子36は、活性層45の長さの1 /3のみに沿って設けられている。

【0028】また、回折格子36は、均一の深さ(図3 の符号a)を有している。本実施形態では、回折格子3 6の深さa (回折格子36の最上部と最下部との距離) は300人である。

【0029】回折格子36は、いわゆるチャープ回折格 子である。つまり、回折格子36の周期(図3の符号 10 Λ)は、回折格子36の長手方向、すなわち縦方向(図 1のz方向) に沿って連続的に変化する。したがって、 回折格子36の回折波長(ブラッグ反射波長)も長手方 向に沿って連続的に変化する。なお、周期変化が連続的 であるという点で、回折格子36は、位相シフト回折格 子とは異なる。

【0030】半導体レーザ素子100の動作時には、回 折格子36の長手方向の各部位と後端面34との間で帰 還が生じる。つまり、回折格子36と後端面34とによ って共振器が形成される。回折格子36のうち位相条件 を満たす部位だけが正帰還を生じさせる。この場合、レ ーザ発振が起とる。回折格子36の周期の変化範囲が広 ければ、複数の波長で正帰還が生じうる。周期の変化範 囲が十分に広ければ、複数の縦モードが発振しうる。し たがって、マルチモード発振を達成できる。

【0031】回折格子36は、レーザ素子100の発振 波長範囲において、前端面32よりも高い反射率を有し ている。発振波長範囲とは、レーザ素子100の発光ス ベクトラムに含まれる複数の縦モードの包絡線の波長範 囲である。したがって、回折格子36は、発振する各縦 有している。これにより、キンクの発生が防止される。 との点については、後述する。

【0032】再び図2を参照し、MQW-SCH層14 を構成する各層の寸法について説明する。第1 および第 2SCH層42、44の厚さは、それぞれ150Aであ る。各バリア層46の厚さは100人であり、各井戸層 48の厚さは50Aである。第3SCH層50の厚さは 150Aであり、第4SCH層52の基本厚は100A である。上述のように、第450日層52の上面には、 回折格子36が設けられている。したがって、第450 H層52の厚さは縦方向(z方向)に沿って周期的に変 動する。本明細盤において「基本厚」は、第480円層 52のうち回折格子36を除いた部分の厚さをいう。と れは、第480円層52の下面から回折格子36の最下 部(最深部)までの距離に当たる。基本厚は、縦方向の 位置によらず一定である。基本厚をd、回折格子36の 深さをaとすると、第4SCH層52の厚さは、縦方向 に沿ってdとd+aの間で周期的に変動する。

【0033】活性層45の幅を調整すると、横モードを 6は、前端面32に隣接している。回折格子36の長さ 50 単一にできる。横方向のシングルモード化のためには、

活性層45の幅は約1~約5μmであることが好まし い。本実施形態では、活性層45の幅は約4μmであ る。横モードが単一であると、ファーフィールドバター ン(FFP)が安定するので、半導体レーザ素子100 と光ファイバと結合が容易になる。これは、半導体レー ザ素子100をラマンアンプの励起光源として使用する うえで有益である。

【0034】上部電極層28および下部電極層30を介 して半導体レーザ素子100に順方向電圧を印加する ザ発振の原理は、DFBレーザと同様である。すなわ ち、回折格子36がレーザ共振器として機能することに より誘導放出が促され、レーザ発振が起こる。

【0035】図5は、半導体レーザ素子100の発光ス ベクトラムを示している。図5に示されるように、半導 体レーザ素子100はマルチモード発振(縦多モード発 振) する。これは、上述のように、回折格子36の周期 が一定でないことに起因する。

【0036】なお、本発明の半導体レーザ素子の発光ス ベクトラムに含まれる縦モードの数は任意であり、特に 20 の良い回折格子を作りやすい。 上限を定める必要はない。また、発光スペクトラム幅 は、約10 n m以下であることが好ましい。ここで、

「発光スペクトラム幅」は、発光スペクトラムに含まれ る複数の縦モードの包絡線の幅を指す。

【0037】半導体レーザ素子100の発振波長は、回 折格子36の周期変化の範囲に応じて、ほぼ決まる。し たがって、周期変化の範囲を調整することにより、発光 スペクトラムの広がりを自由に制御できる。このため、 周期変化の範囲を適切に設定すれば、十分に狭い発光ス ベクトラム幅が得られる。

【0038】半導体レーザ素子100は、ラマンアンプ の順方向励起光源として好適に使用できる。これには、 四つの理由がある。第1に、半導体レーザ素子100の レーザ光は光ファイバ内で散乱しにくい。これは、半導 体レーザ素子100がマルチモード発振するからであ る。第2に、半導体レーザ素子100は、外部ファイバ ブラッググレーティング共振器型レーザに比べて、相対 雑音強度(RIN)が小さい。これは、半導体レーザ素 子100は内部共振器型であるため、共振器内に外乱が 入り込みにくいからである。第3に、半導体レーザ素子 40 100は優れた波長安定性を有する。半導体レーザ索子 100のレーザ発振波長は、回折格子36の周期によっ て実質的に定まる。したがって、既存のDFBレーザと 同様に、波長の電流依存性・温度依存性が小さい。第4 に、半導体レーザ素子100は、ラマンアンプの順方向 励起光源として十分に狭い発光スペクトラム幅を有する ことができる。狭い発光スペクトラム幅は、回折格子3 6の周期変化の範囲を適切に設定することにより得られ

【0039】また、半導体レーザ素子100は、キンク 50

を生じさせないという利点も有している。これは、発振 する縦モードの波長に対して、回折格子36が前端面3 2よりも高い反射率を有しているからである。以下で は、との点について説明する。

【0040】回折格子36および後端面34間の共振に より生じるモードを、DFBモードと呼ぶことにする。 このDFBモードのほかに、前端面32および後端面3 4間での共振により発生するモードもある。 これがファ ブリペローモード (FPモード) である。 DFBモード と、半導体レーザ素子100はレーザ発振をする。レー 10 とFPモードが同程度の強度を有していると、モード競 合によってキンクが発生する。

> 【0041】回折格子36は、発振する縦モードの波長 に対して、前端面32よりも高い反射率を有している。 このため、FPモードの強度はDFBモードの強度より も十分に低くなる。したがって、モード競合を防ぎ、そ れによってキンクも防ぐことができる。

> 【0042】レーザ素子100には、次のような利点も ある。レーザ素子100では、回折格子を設ける位置が 活性層上の一部分に限定されているので、均質で歩留り

【0043】レーザ素子100には、高い光出力を達成 しやすいという利点もある。これは、回折格子36が後 端面34に隣接せず、前端面32に隣接しているからで ある。回折格子をレーザ素子の後端面に隣接させて設け ると、共振器長が短くなるので、十分な利得を得にく い。共振器長は、後端面と回折格子の先端(後端面から 遠い方の端)との間の距離である。したがって、回折格 子の長さが一定であれば、回折格子が後端面に近いほ ど、共振器長は短くなる。逆に、回折格子を前端面に近 30 づけるほど、共振器長が長くなるので、高い光出力を得 やすい。

【0044】なお、回折格子36と前端面32は、離間 させる必要がない。前端面32の反射率は低いので、回 折格子36の前端面32での位相は、DFBモード間の しきい値利得差にあまり影響を与えないからである。

【0045】以上、本発明をその実施形態に基づいて詳 細に説明した。しかし、本発明は上記実施形態に限定さ れるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範 囲で様々な変形が可能である。

[0046]

【発明の効果】本発明の半導体レーザ素子は、マルチモ ード発振をするので、光ファイバ内で散乱しにくいレー ザ光を発する。また、本発明の半導体レーザ紫子は、そ の内部に設けられた回折格子によってレーザ共振器が構 成されているので、RINが低く、波長安定性に優れ る。また、回折格子の周期変化の範囲を適切に設定すれ ば、十分に狭い発光スペクトラム幅が得られる。したが って、本発明の半導体レーザ素子は、ラマンアンプの順 方向励起光源として好適に使用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態の半導体レーザ素子100の構造 を示す斜視図である。

【図2】MQW-SCH層14のバンドギャップ波長の 分布を示す図である。

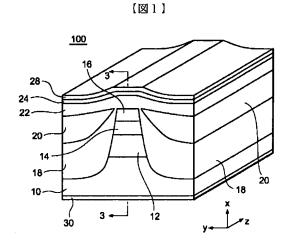
【図3】半導体レーザ素子100の縦断面図である。

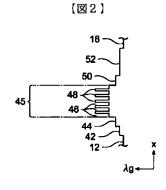
【図4】半導体レーザ素子100の平面断面図である。

【図5】半導体レーザ素子100の発光スペクトラムを 示す図である。

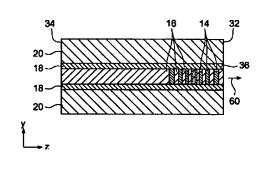
【符号の説明】

\*10…基板、12…下部クラッド層、14…MQW-S CH層、16…第1上部クラッド層、18…埋め込み 層、20…電流ブロック層、22…第2上部クラッド 層、24…コンタクト層、28…上部電極層、30…下 部電極層、32…前端面、34…後端面、36…回折格 子、42…第1SCH層、44…第2SCH層、45… 活性層、46…バリア層、48…井戸層、50…第3S CH層、52…第4SCH層、100…半導体レーザ素 子。





【図3】 22 16-4 14-12-10



[図4]

【図5】

